

亞洲電材股份有限公司
Asia Electronic Material Co., Ltd.
上櫃前業績發表會公司簡報

報告人：李建輝 董事長

報告日期：2011/8/19

重要揭露事項

(一)風險事項（詳閱公開說明書）

- 該公司面對攜帶式設備如手機、平板電腦、筆記型電腦市場變化快速之影響及具體因應措施之說明。
- 該公司面臨同業技術及價格競爭風險採行具體因應措施之說明。
- 該公司對如何掌握PI、銅箔等關鍵原料暨因應日本大地震對原料取得影響及具體因應措施之說明。

(二)營運概況（詳閱公開說明書）

- 該公司如何提升2L-FCCL之市占率及具體措施之說明。
- 該公司研發人員99年度離職率為40%，其比率偏高之原因、影響及如何強化研發能力之說明。

重要揭露事項(續)

3. 特別記載事項乙節補充揭露該公司98、99年度及100年第一季銷售有鹵存貨金額分別為206,003仟元、228,143仟元及48,787仟元，其原因、存貨呆滯損失提列情形及相關風險之說明。
4. 推薦證券商於評估報告中對於該公司以下項目說明之評估意見：
 - A. 對該公司業績變化合理性及未來發展性之評估意見。
 - B. 對該公司轉投資事業營運概況及未來轉撥計價政策之評估意見。
 - C. 對該公司面對攜帶式設備如手機、平板電腦、筆記型電腦市場變化快速之影響及具體因應措施說明之評估意見。

重要揭露事項(續)

- D. 對該公司面臨同業技術及價格競爭風險採行具體因應措施說明之評估意見。
- E. 對該公司對如何掌握PI、銅箔等關鍵原料暨因應日本大地震對原料取得影響及具體因應措施說明之評估意見。
- F. 對該公司如何提升2L-FCCL之市占率及具體措施說明之評估意見。
- G. 對該公司研發人員99年度離職率為40%，其比率偏高之原因、影響及如何強化研發能力說明之評估意見。
- H. 對該公司98、99年度及100年第一季銷售有鹵存貨金額分別為206,003仟元、228,143仟元及48,787仟元，其原因、存貨呆滯損失提列情形及相關風險說明之評估意見。

報告大綱

- 公司願景
- 公司概况
- 營運概況
- 研發概況
- 經營績效
- 展望未來
- 重要揭露事項

公司願景

- 全中國最大軟板材料生產基地
- 全世界性價比最高的軟板材料公司
- 全中國服務最好的軟板材料公司



公司概況

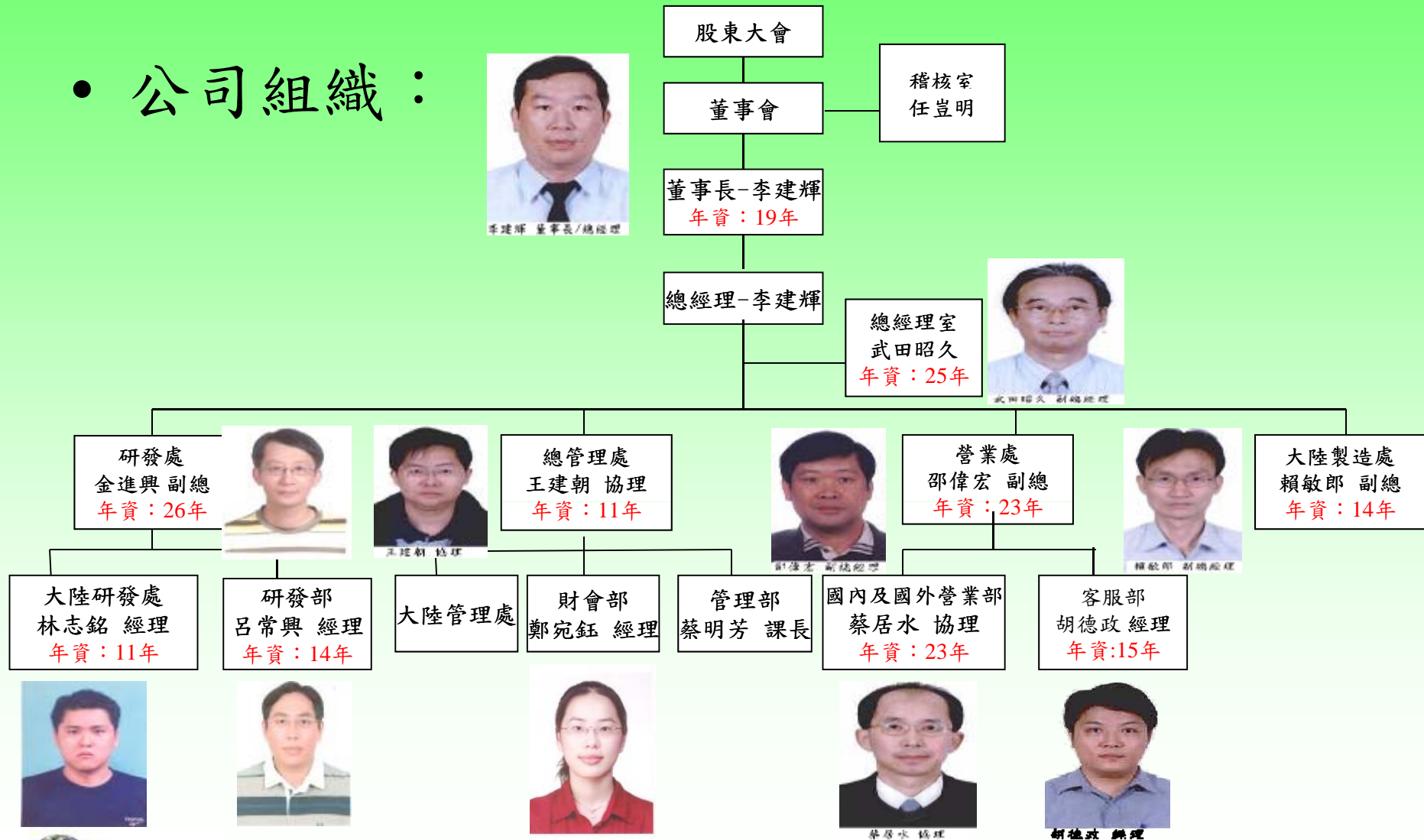
- 公司簡介：
 - 設立日期：2003/7/7
 - 負責人：李建輝 董事長
 - 實收資本額：652,259仟元
 - 員工人數：台灣26人；大陸265人
 - 主要產品：軟性銅箔基板(有膠及無膠)、覆蓋膜、補強板及純膠
 - 產品應用：智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、數位相機及顯示器模組等

公司沿革



公司概況（續）

• 公司組織：



公司概況（續）

• 人力結構：

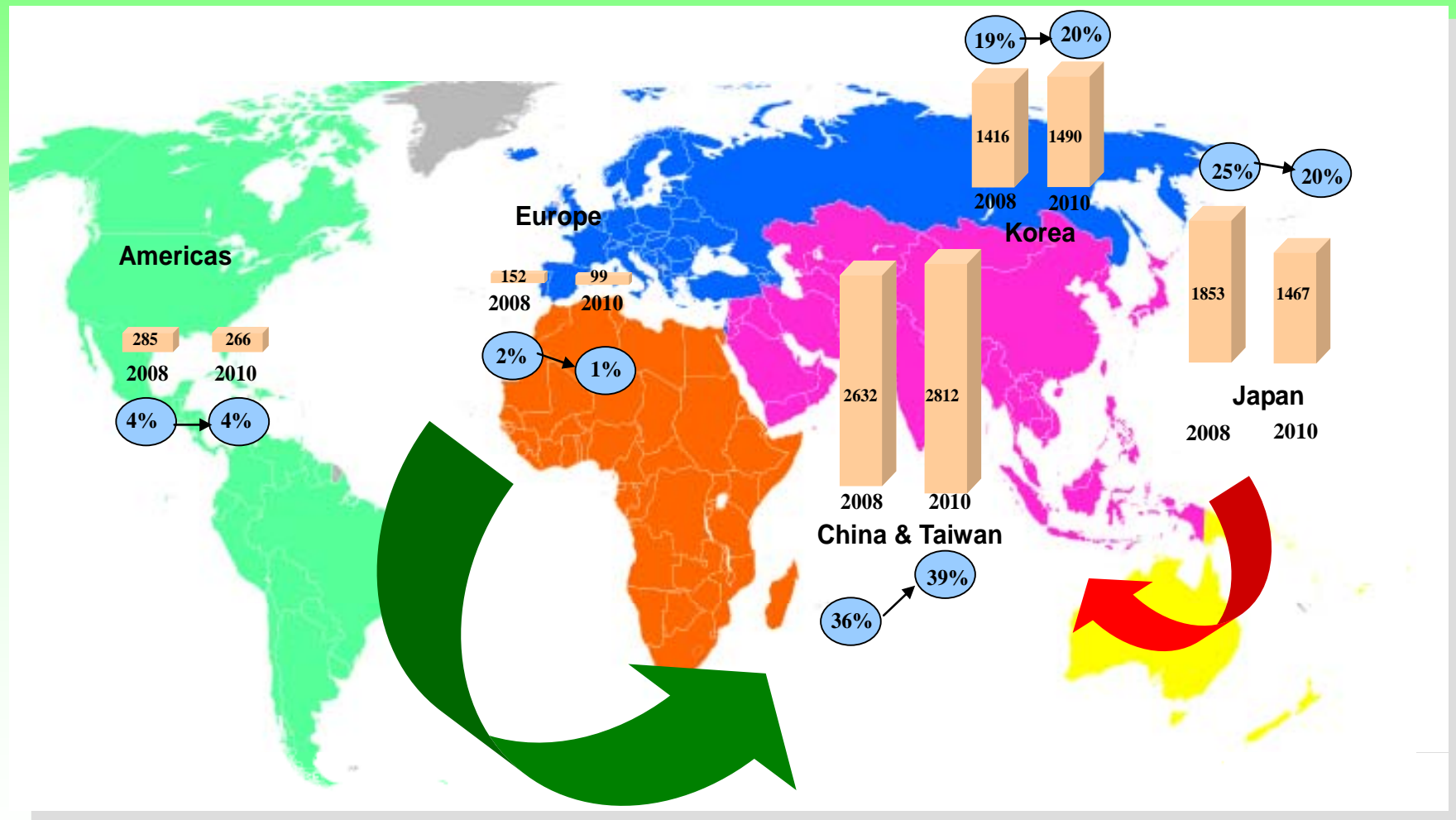
公司別 職稱 部門	亞電						雅森					總計
	協理 以上	經(副) 理	課長	主任	其他	小計	課長	組長	領班	其他	小計	
管理人員	2	1	3	0	4	10	5	15	13	31	64	74
業務人員	3	1	0	0	1	5	8	9	8	8	33	38
研發人員	2	3	1	2	3	11	5	3	4	1	13	24
工程人員	0	0	0	0	0	0	6	15	27	107	155	155
合計	7	5	4	2	8	26	24	42	52	147	265	291

大陸已培養100名以上幹部，其中組長級以上平均年資超過五年

	2008	2009	2010
合併營收(仟元)	498,470	759,923	1,334,363
人數(含子公司)	211	226	272
人均產值(仟元)	2,362	3,362	4,906

營運概況

- 軟板產業趨勢：生產供給鏈明顯移轉至大中華地區



營運概況 - 產業鏈

上游

•原料

PI Film

杜邦
鐘淵化學
達邁
科隆

銅箔

日礦、Olin
福田、李長榮
台灣銅箔
三井金屬

接著劑

台虹、亞電、
杜邦、旗勝、
律勝、長捷士

中游

•基材及軟板

軟性銅箔 基板

台虹、亞電、律勝、
新揚科、旗勝、長
捷士

軟性印刷 電路板

嘉聯益、圓裕、
欣興同泰、旗勝、
毅嘉、台郡、
BYD

下游

•印刷電路板成品應用範圍

下游應用 產品

NB：廣達、仁寶、英業達、宏碁等

手機：Apple、HTC、Rim、Nokia等

數位相機：佳能、華晶科、亞洲光學、
普立華等

液晶顯示器：友達、奇美、勝華等

PC周邊相關：廣明光電、TDK等

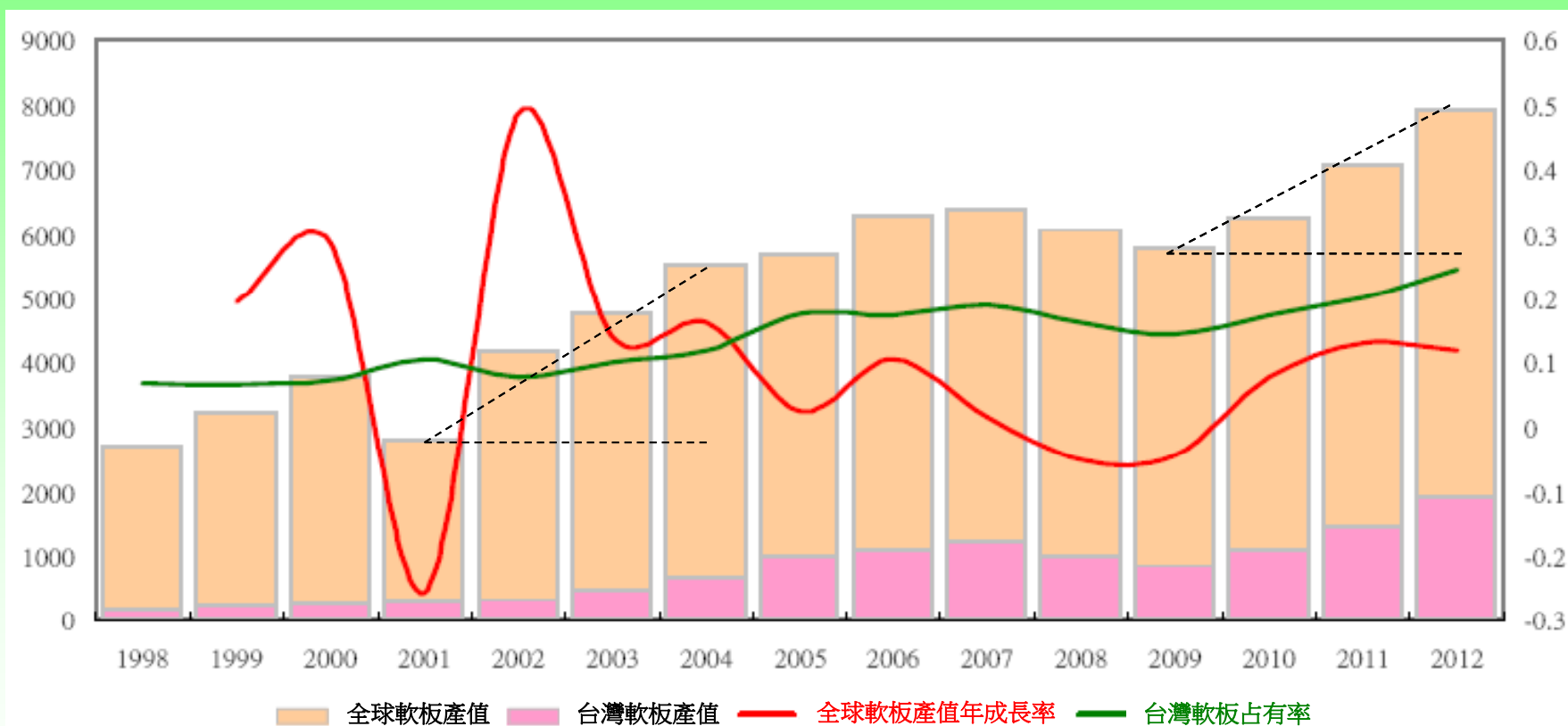
其他：汽車、軍事、航太工業等



營運概況 (續)

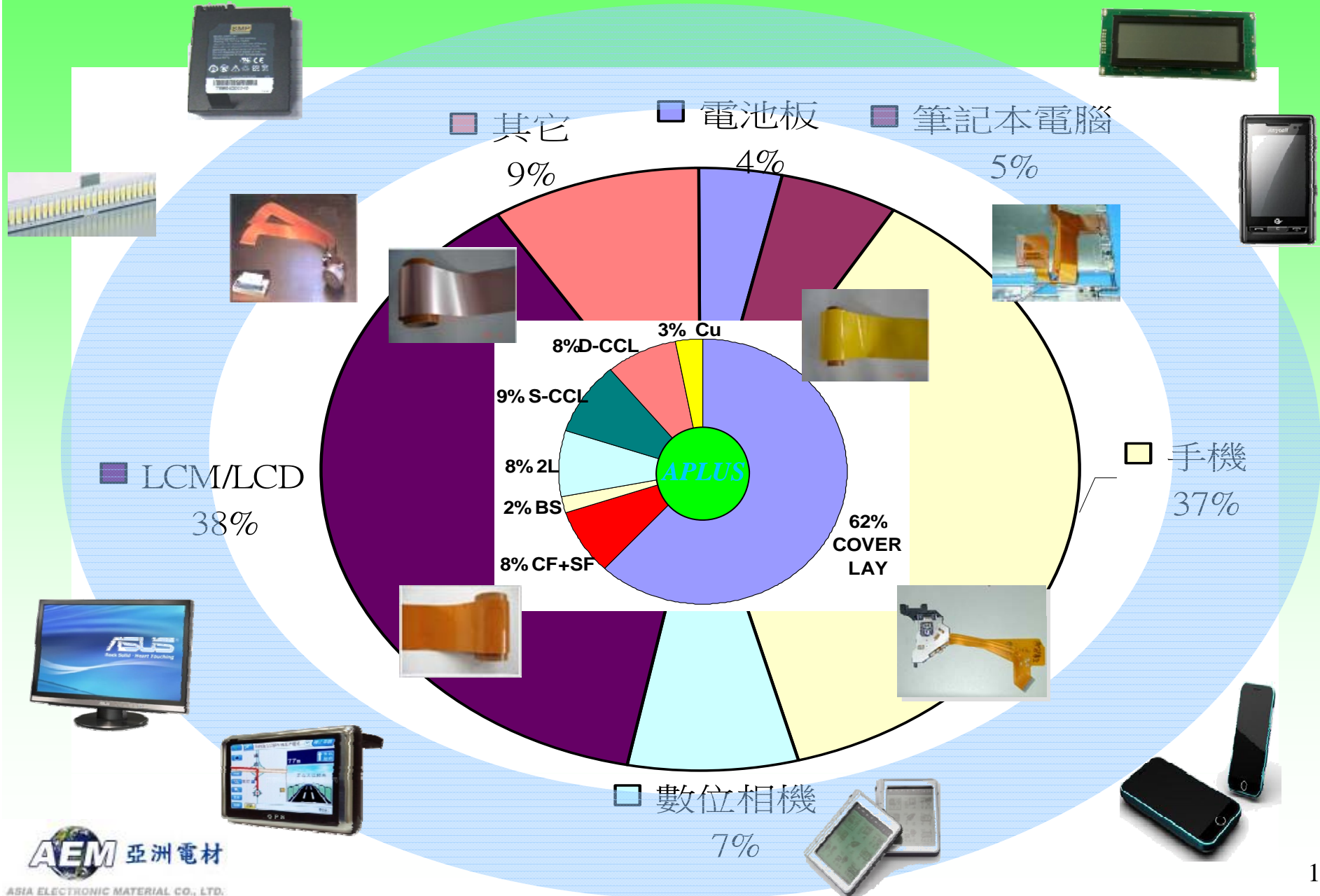
- 軟板產業趨勢：

單位：百萬美元

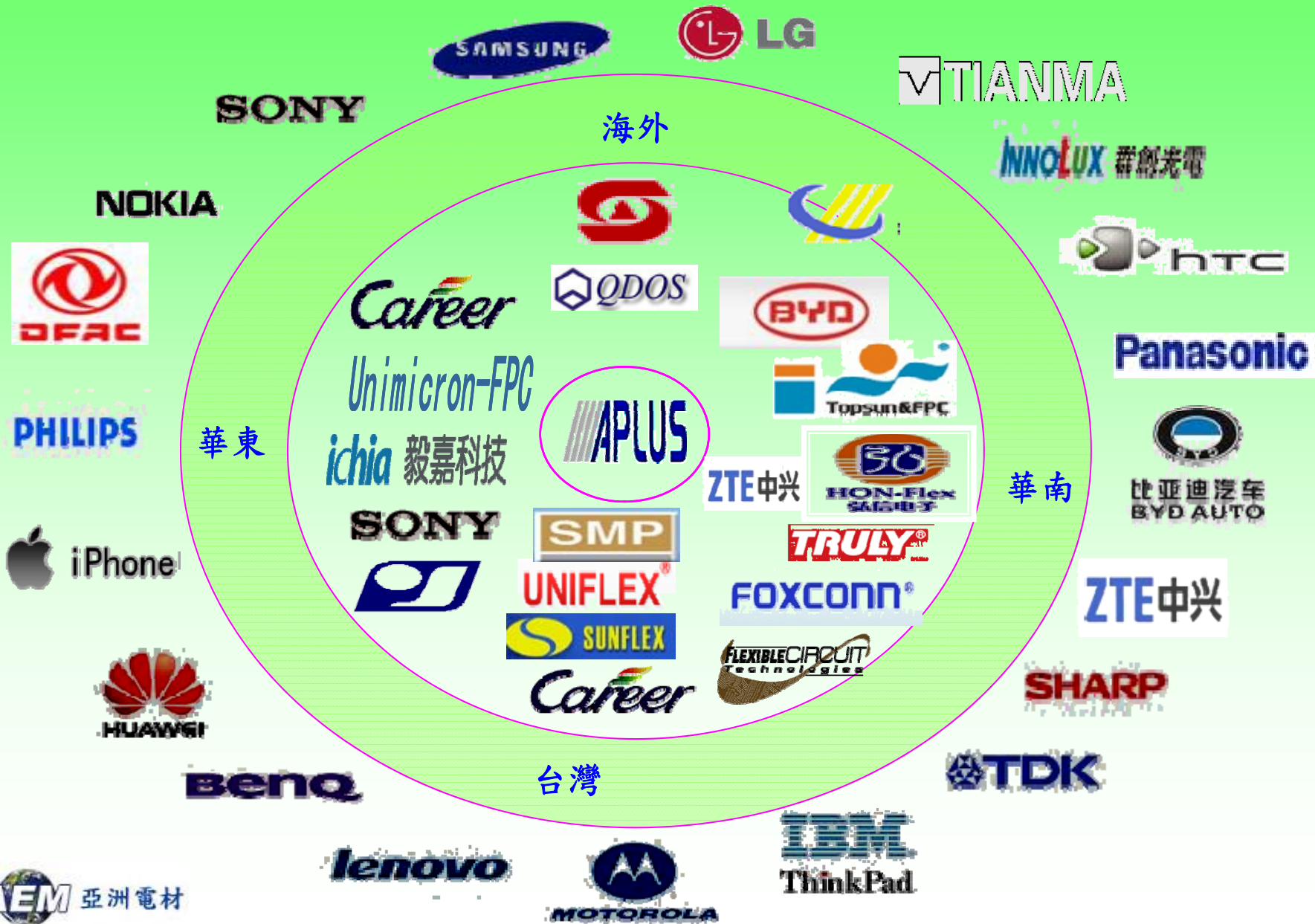


Source : IEK、Capital estimates

產品類別/應用



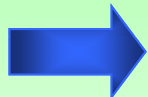
客戶及終端客戶



經營契機

- 楔子

- 中國內需消費性電子產品市場崛起
- 勞力/材料成本低廉
- 山寨市場興起

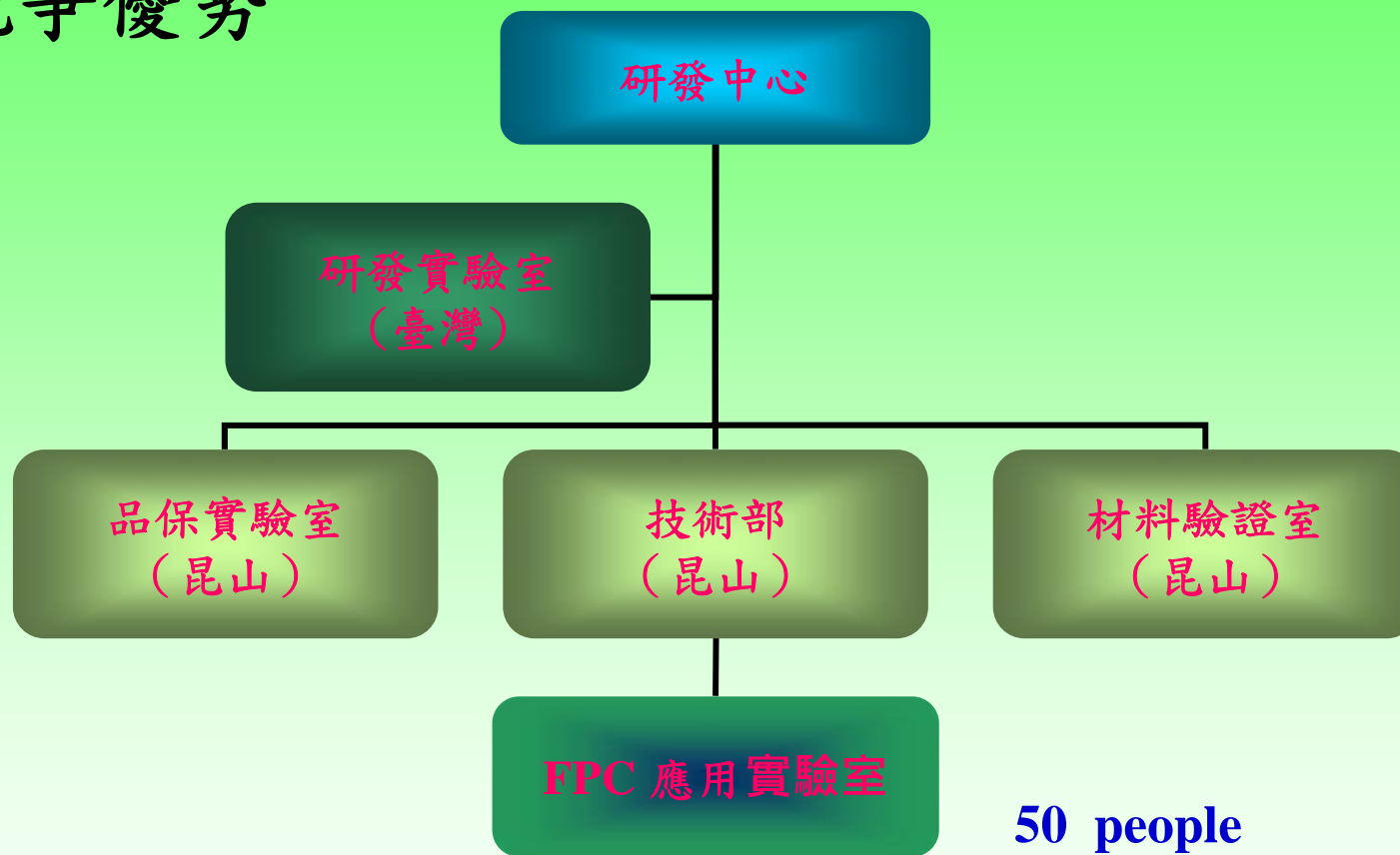
 公司營運生產成本低

BUT...

- 產品品質
- 產品功能
- 智慧財產權

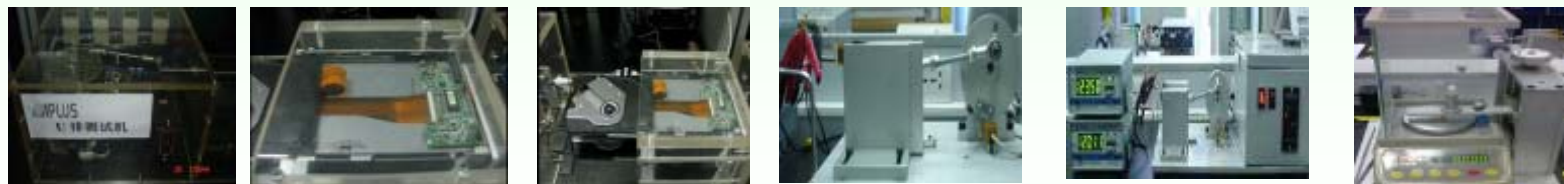
研發架構

核心競爭優勢

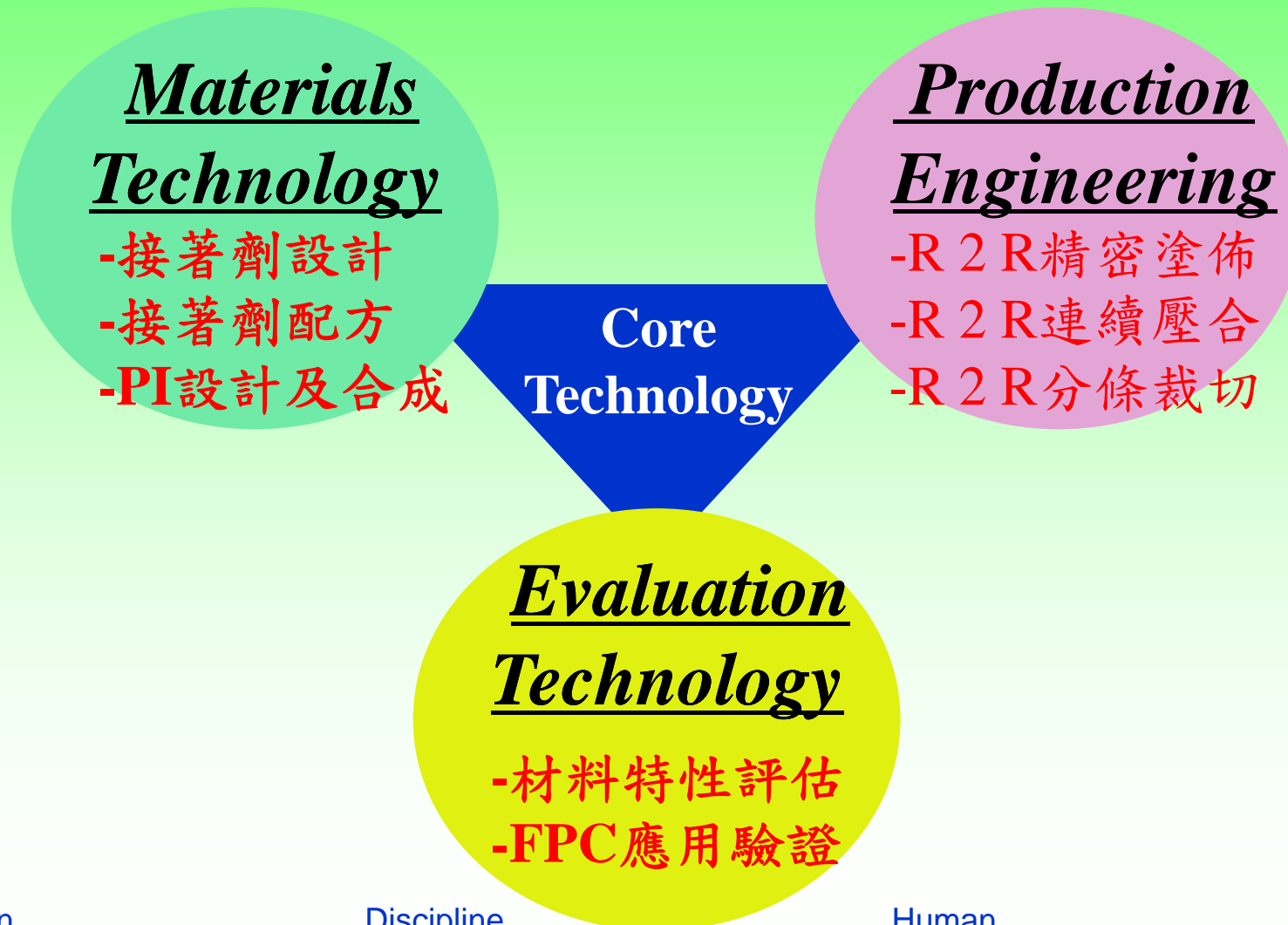


50 people

一流材料驗證室



亞電的核心技術

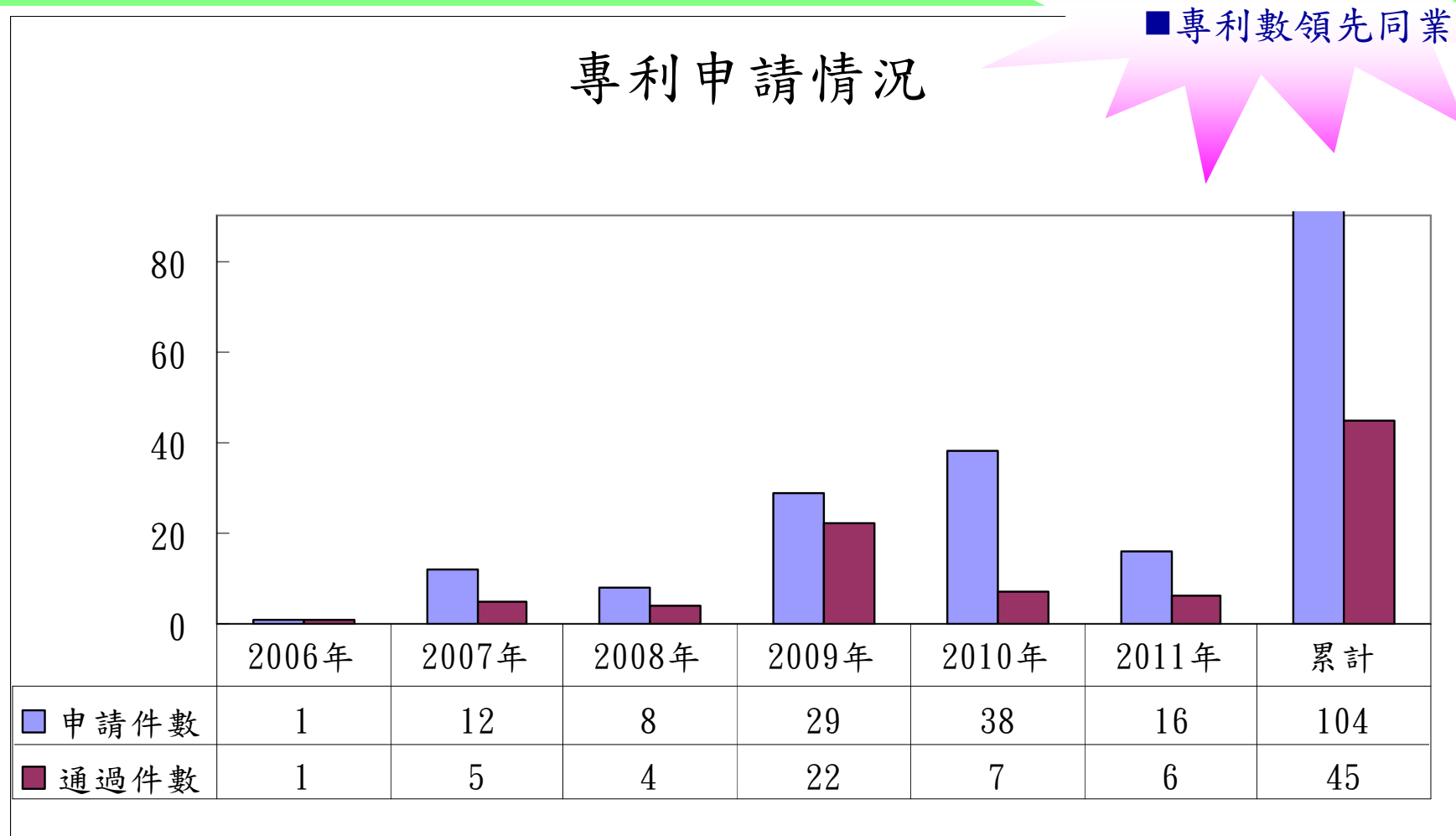


研發概況-專利篇數

•持續不斷創新研發能力

■ 專注研發
■ 專利數領先同業

專利申請情況



研發概況-產品發展方向

綠色環保

薄型化技術

高階軟板材料

綠能環保材料

80% 產品

- ◎ 無鹵無銻
 - 3-CCL
 - Coverlay
 - Bonding sheet
 - Stiffener
- ◎ 無鹵系列

- ◎ 雙面2-FCCL
- ◎ 單面2-FCCL

複合型基板
高頻高速基板材料
阻抗匹配基板材料

鋰電池包裝材料-鋁塑膜
太陽能背板材料
觸控面板OCA薄膜

20% 產品

- ◎ 有鹵系列

◎：已通過客戶認證

◎ 複合型雙面板及綠能環保材料
創造營收大幅成長

◎ 無鹵膠系(覆蓋膜、補強板)建立自有品牌與口碑，品質領先同業



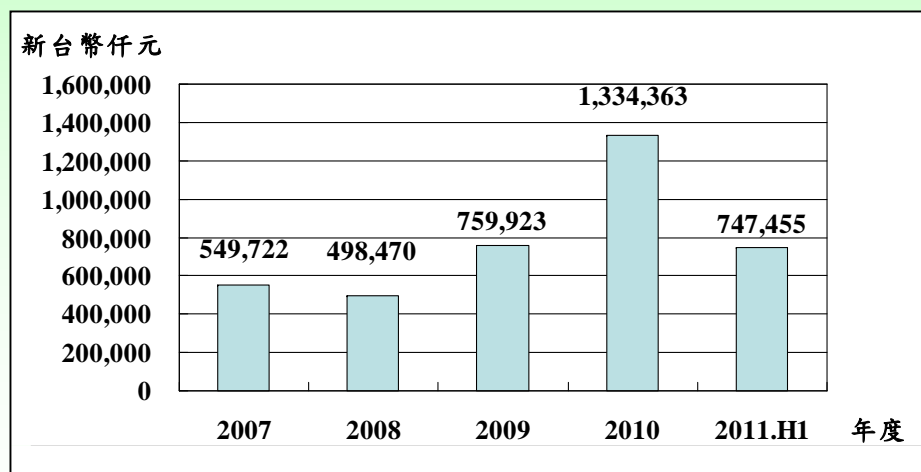
經營績效

•2007-2011年上半年度合併營收、稅後盈餘

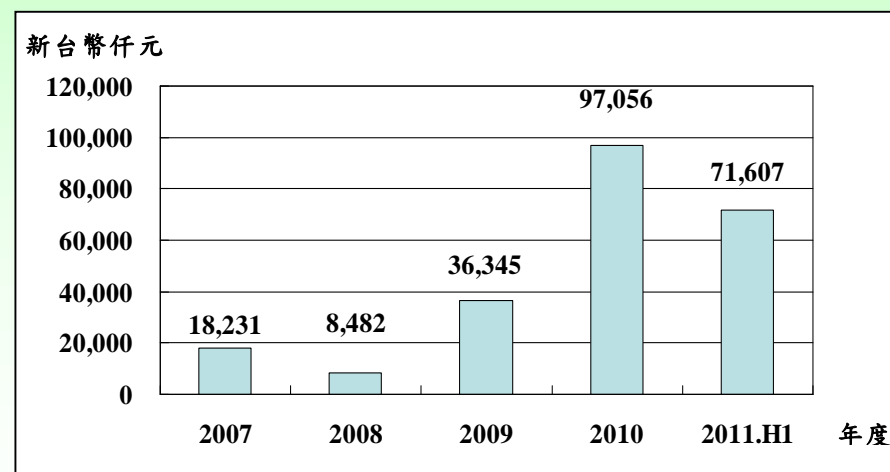
單位：新台幣仟元

	2007	2008	2009	2010	2011.H1
合併營收	549,722	498,470	759,923	1,334,363	747,455
稅後盈餘	18,231	8,482	36,345	97,056	71,607

•合併營收

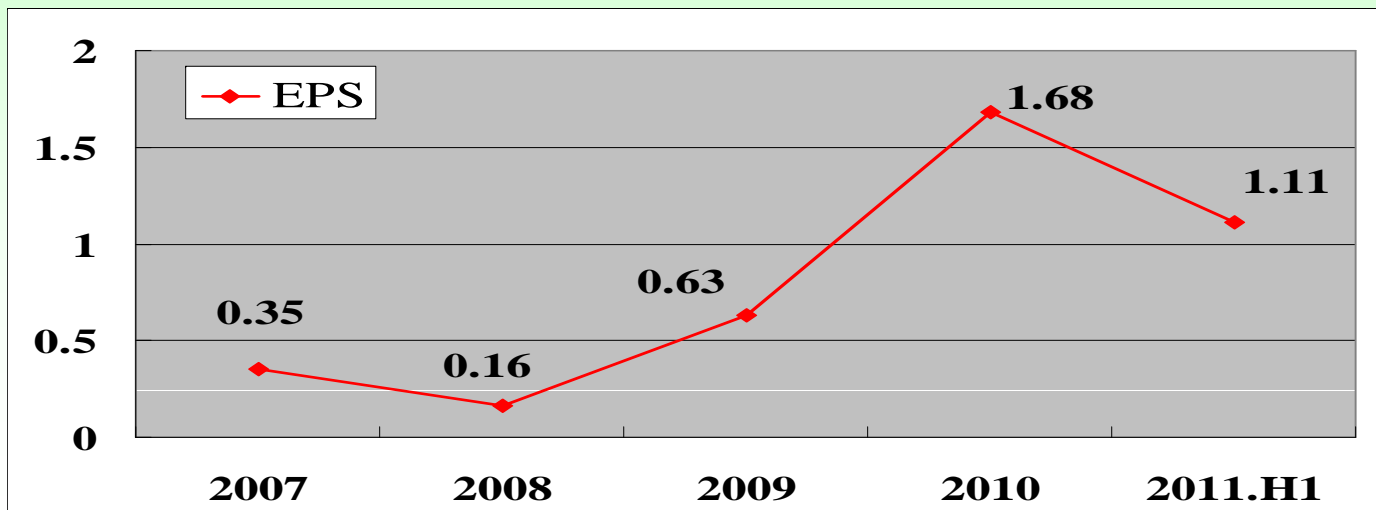
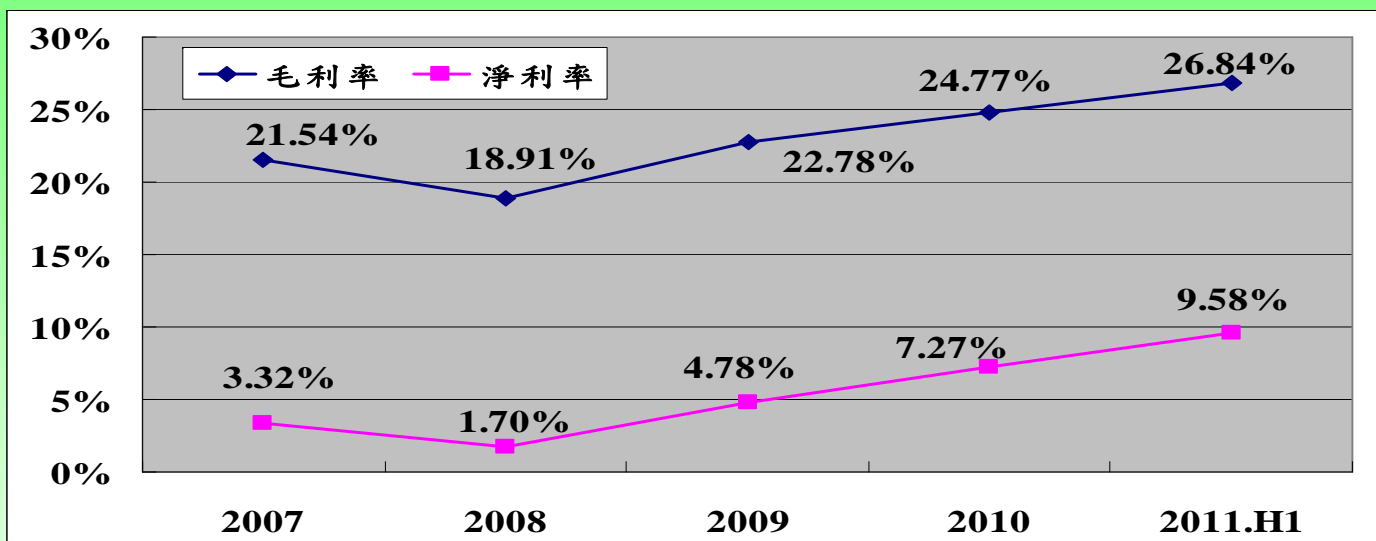


•稅後盈餘



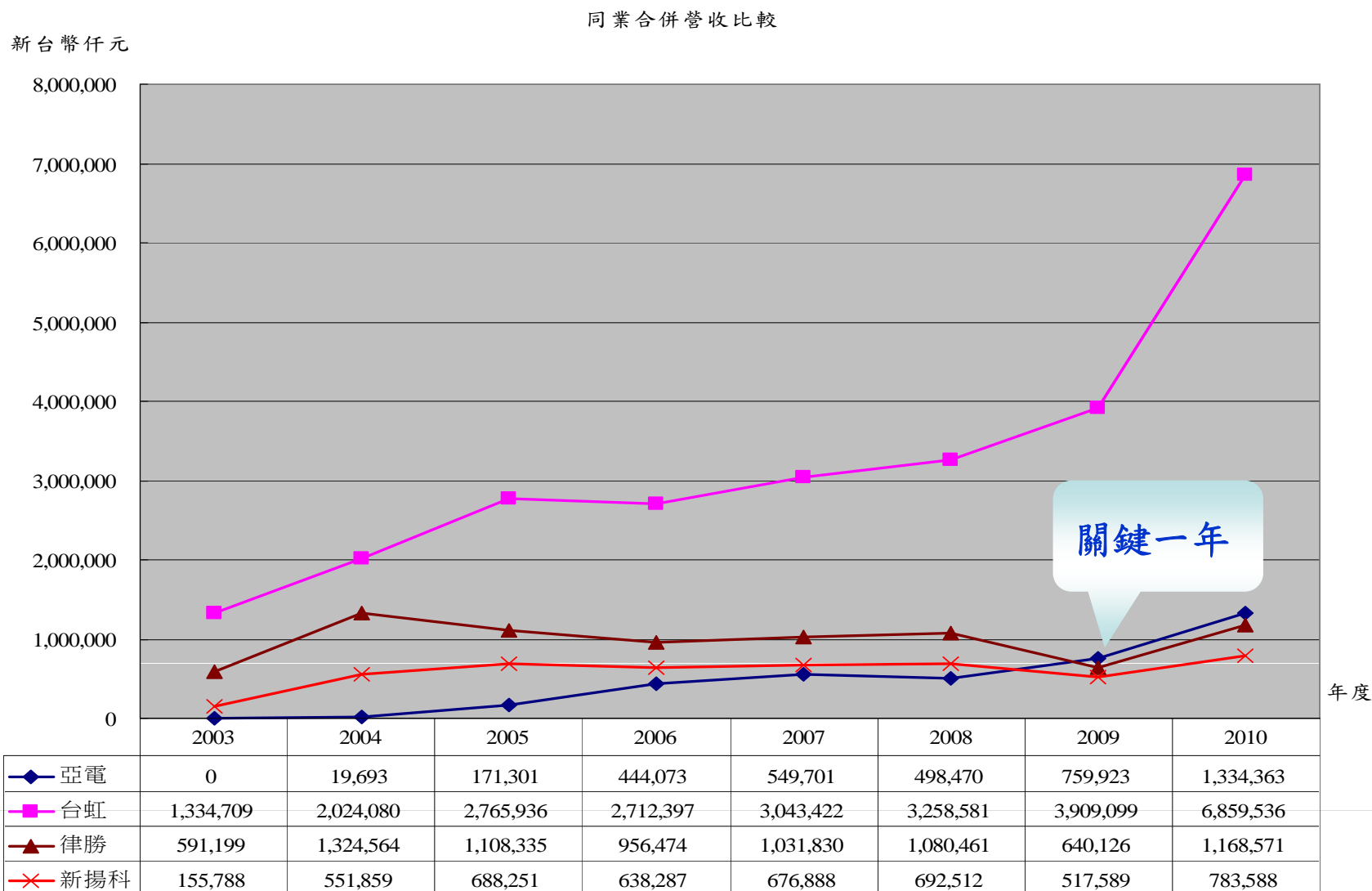
經營績效 (續)

•2007-2011年上半年度毛利率、淨利率及每股盈餘



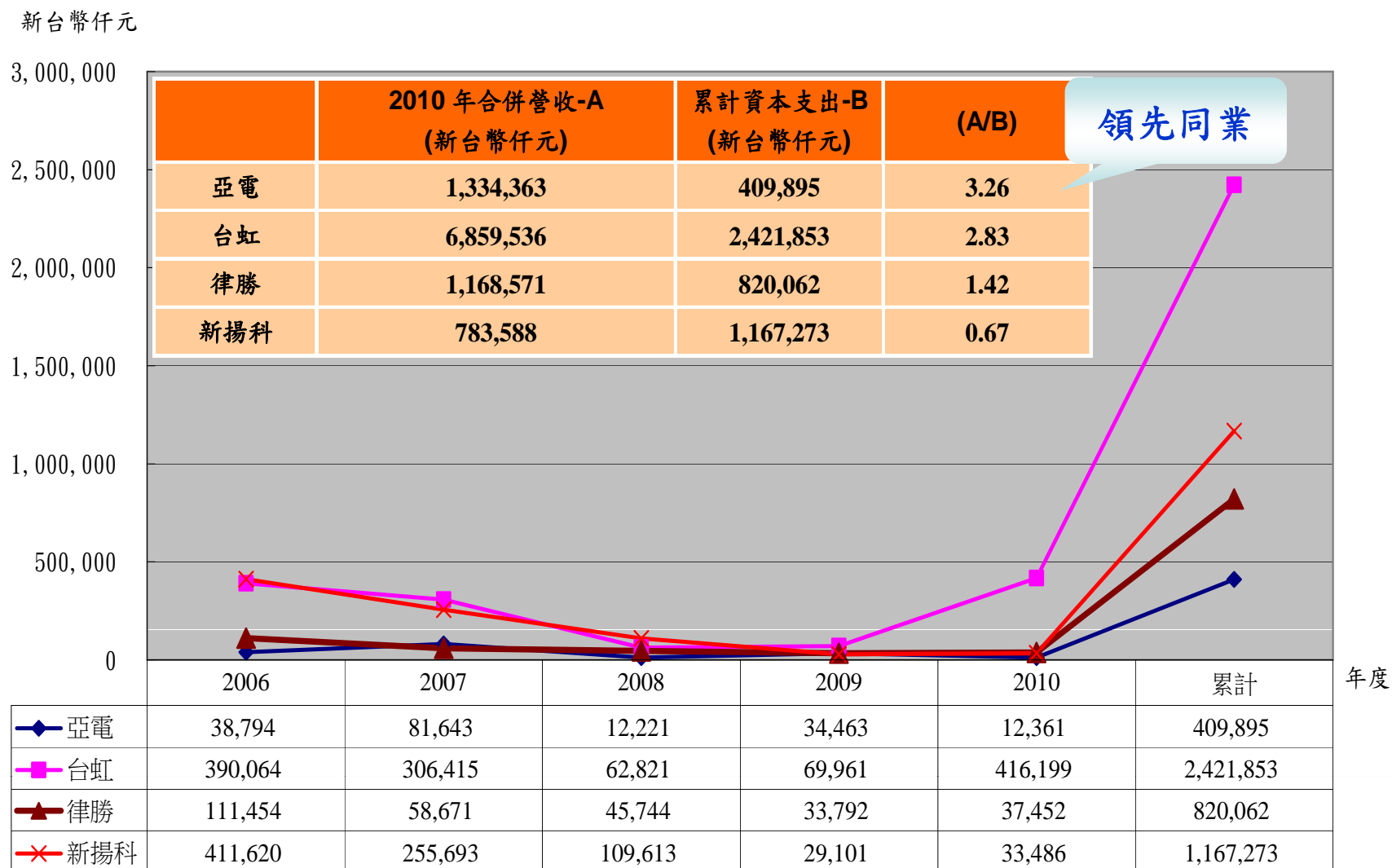
經營績效 (續)

- 同業合併營收比較



經營績效 (續)

• 同業資本支出比較

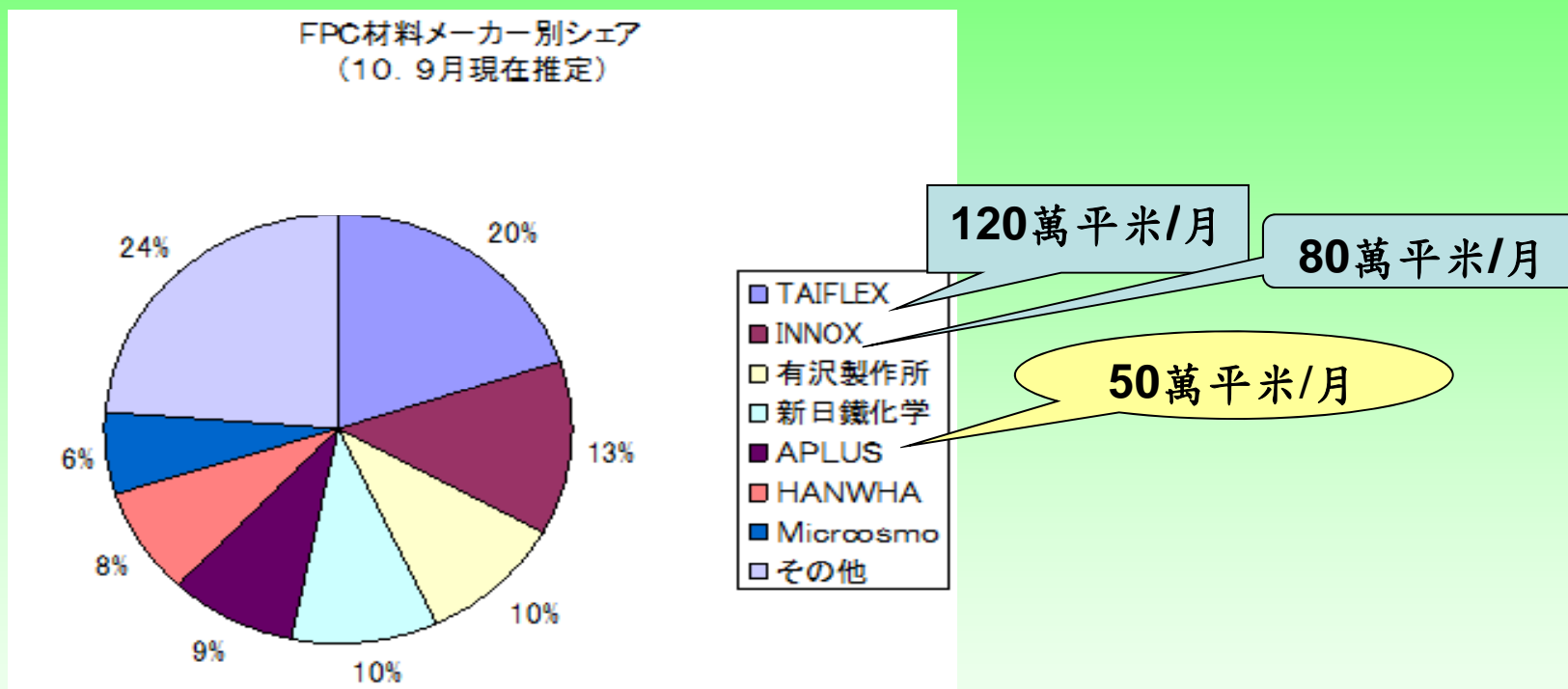


公司願景

- 全中國最大生產軟板材料基地
 - 目前產能每月80萬平米。
- 全世界最高性價比的軟板材料公司
 - 2010年平均單位製造費用每平方米RMB5元，預計產能擴充後，可發揮規模經濟效果。
- 全中國服務最好的軟板材料公司
 - 未來軟板重心移至大中華地區，亞電在地生產，可就近服務客戶。
 - 服務團隊具有多年軟板經驗，兩岸業務人員共38人，其中課長級以上為12人，佔32%。

展望未來

- 成為全球軟板材料前三名的公司。



- 架設兩岸分工平台，跨入新能源材料領域

～感謝蒞臨指導～